

Interview with Mr. Yamamoto, CEO of EVG Japan FY2021 Orders Reach Record High. Supporting Customers with NIL and Contract Manufacturing. – December 9, 2021



1面の続き
まずは、星元の業績から教えて下さい。

インタビュー

EVGジャパン

山本代表に聞く

山本 21年度(21年9月期)における全社ベースでの受注高は前年度比で1桁台後半の伸びを見せており、受注高としては過去最高を記録した。量産用途が全体の8割を占めており、これまで開発案件から携わってきたものが、続々と量産に移行していることが昨今の成長につながっている。分野別では引き続き、ナノインプリントソグラフィ(NIL)などが好調だ。最近の目立った動きとしてはNIL向けの新材料開発に向けて、材料メーカー各社からの引き合いが来ていることも挙げられる。

山本 8月に「EVGストップ&リビ

21年度受注高は過去最高
NIL 受託製造で顧客支援

山本 日本法人においては、全社ベースと同様に受注高として前年度比1桁台後半の伸びを21年度に記録することができた。20年度はNIL関連の受注が非常に多かったが、21年度はMEMS関連が全体の5割強を占めるなど、ユニークな年になった。

また、化合物ウエハー関連と先端パッケージ向けもこれに続くかたちで、全体に占めるウエートは大きかった。製品別ではボンダーとボンダーが受注の主軸を阻んだ。

山本 MEMSやLED、イメージセンサーがウエハー接合の主なアプリケーションであったが、近年はプロセスの微細化やスケールアップを補う目的で、ウエハー接合のニーズが増している。チップレットや2.5/3Dパッケージに代表される先端パッケージ分野がそれに該当し、世界的に非常に大きな事業エリアとなっている。近年はそれに加えて、CMOSセンサーリングそのものでもウエハー接合を採用する期待が高まっている。具体的には、CDEやB

ONDSCALEなどは、まさに前工程プロセスでの採用を想定した設計となっており。

山本 「Mill into One」をテーマに、ドラッグティクスの転換期を迎えた半導体業界に対して、いかに自由な発想でデバイスを作り上げていくのかに焦点を当てながら、我々の取り組みや提案を紹介できればと考えている。

山本 今期も高い目標で事業を展開できそうなので、先端基板関連やMEMS、NILなど幅広いアプリケーションで引き合い・受注を獲得できそうです。全社ベースでもミックスの広がりが顕著で、多くのアプリケーションにおいて星元案件の獲得が見込めそうです。(聞き手・編集長 稲葉 雅)